

E by **DEK**



E 方案的最新成员：E by DEK

**简单高效 –
中速 SMT 印刷新标杆**



ASM 的 SMT E-方案 现已整装待发!

通过推出 E by SIPLACE 解决方案, ASM 在质量、性能和灵活性方面, 为中速贴装市场树立了新标杆。现在, 我们正式推出相关的印刷解决方案: E by DEK。

其结果是: 面向未来的, 综合全能, 适用于合同制造商, 柔性电路板生产商, 原型和高混合生产环境。

E-质量

- 超过40年的设计经验
- 稳定可靠的印刷流程
- 极小间距应用也应对自如

ASM E-Line Monitor
让生产透明度最大化



E-性能

- 8 秒印刷周期、快速换线设置以及高重复精度
- 带来全方位最佳成效
- 不同应用配套以便满足各种需求

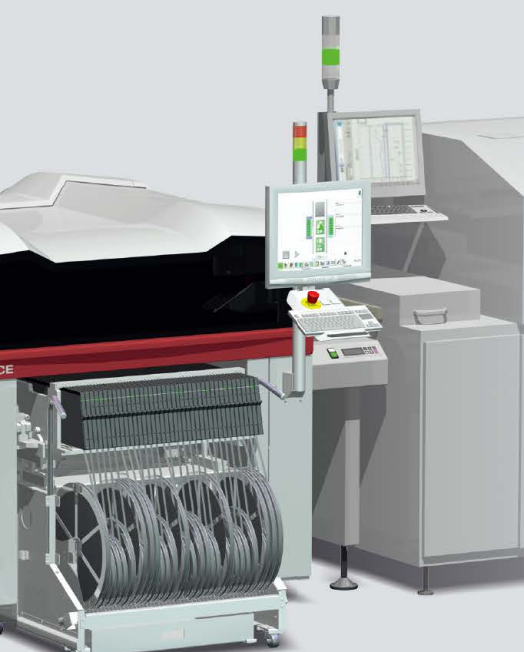
E-灵活性

- 支持所有主要语言
- 兼容广泛的钢网尺寸
- 专利的夹边系统
- E-Line Monitor 共用

E by DEK

E-配套

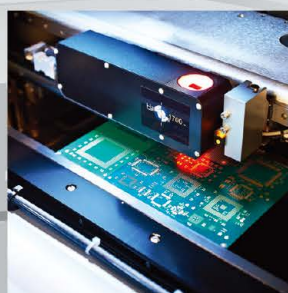
E by DEK 是一个模块化设计的全方位解决方案。
 必须符合未来的需求变化？有了 E by DEK 的应用配套，就不必再投资于新的印刷机了！
 这就是最佳的灵活性！
 这些应用配套可以随时添加。这也是使 E by DEK 达到最佳灵活性的原因。



消费电子配套

把您的 E by DEK 设置成高速的解决方案！

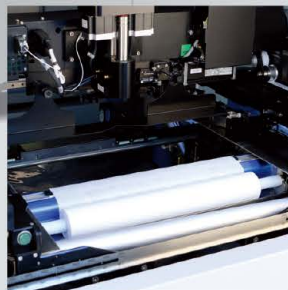
- 8 秒印刷周期
- 双速轨道马达



汽车电子配套

由 E by DEK 确保高品质：

- 焊盘锡膏覆盖率检查
- 进阶统计制程管制
- 焊膏滚动高度监测器



模组配套

独特于此级：迎合柔性板的 E by DEK

- 软板印刷
- 侧夹
- 双速轨道马达
- 可调宽度钢网定位装置
- 半自动钢网装置



LED 配套

印刷超大板，唯有 E by DEK：

- 板长最高达 620 毫米
- 重板轨道
- 远程停板器
- 对应长板的钢网清洁装置（600 毫米）

E by DEK

眼见为实。

E-事实



机械性能	技术数据
校准率	> 2.0 C _{mk} @ ±12.5 μm, (±6 Sigma) *
可重复精度	> 2.0 C _{mk} @ ±25 μm, (±6 Sigma) **
最佳印刷周期	8秒
操作系统	Windows 7 Standard
刮刀力度机制	软件控制, 自动化闭环控制系统
钢网定位	半自动钢网装置
可调宽度钢网定位装置	可调宽度, 以适应钢网大小范围 381毫米 至 736毫米
钢网底部清洁方式	钢网清洁装置 可编程 湿/干/真空
基板尺寸	50毫米 (X) x 40.5毫米 (Y) 至 620毫米 (X) x 508.5毫米 (Y)
基板厚度	2-6毫米
基板重量 (最大)	6公斤
基板翘曲度	7毫米, 包括基板厚度
基板定位器	顶压式侧夹 侧夹 无刀片边夹 真空
温湿度感应器	监测进程环境

* 对准条件包括船上装载/卸载, 板夹, 摄像头/升表机芯, 是由第三方软件QC-CALC计算的能力值。
 ** 机械性能包括船上装载/卸载, 板夹, 摄像头/升表机芯和打印过程。该能力值是由第三方软件QC-CALC计算。



扫描二维码
关注 E方案 官方微信



E-联系信息

我们的目标: 为中速机市场提供最好的解决方案, 并与您一起建立长久的合作关系。是否已被我们说服? 请与我们联系:

E-Contact: e.solutions@asmpt.com
E-Web: www.E-by-DEK.com

此说明书中所指信息仅包含一般性描述以及/或是性能特点, 不具备合同效力。任何详细性能特点/功能均以所签合同为准。如有改动, 恕不另行通知。
 ASM Assembly Systems Ltd. 拥有对本说明书的最终解释权。